

2009年3月期 決算説明会

株式会社ディスコ

2009年5月18日
本社・R&Dセンター A810ホール

将来の見通しに関する注意事項

このプレゼンテーションに掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。

実際の業績に影響を与える重要な要素には、世界・日本経済の動向、急激な為替相場の変動ならびに戦争・テロ活動、災害や伝染病の蔓延等があります。

**1. 2009年3月期決算概要及び
2010年3月期の見通し**

IR室長

小澤 伸一郎

2. 事業環境と経営方針

代表取締役会長

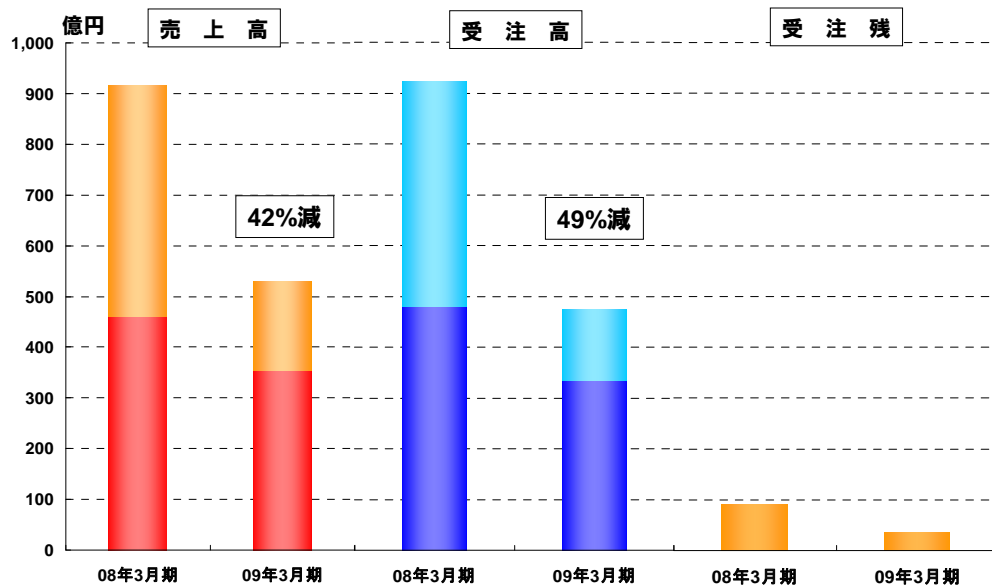
溝呂木 斉

3. 質疑応答

2009年3月期決算概要及び 2010年3月期の見通し

IR室長
小澤 伸一郎

連結売上高・受注高 前期比較

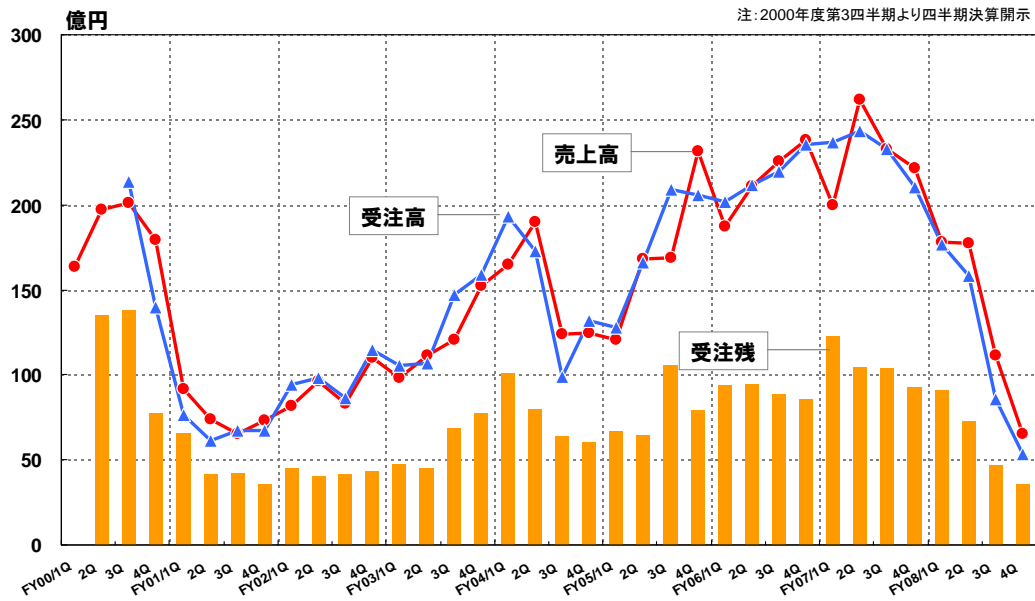


- 売上高・受注高ともに、01年度のITバブル時以来、6年ぶりの大きな落ち込み幅となった
- シリコンサイクルの谷に加え、第3四半期中盤以降、大規模な生産調整の影響を受けた

連結売上高・受注高の前期との比較ですが、2008年度は売上高531億（前期比42%減）受注高474億（前期比49%減）となりました。

売上高・受注高はITバブル崩壊以来の落ち込みとなっています。これはシリコンサイクルの谷に加え、昨年9月の米国金融機関の破たんを契機とした信用収縮により個人消費が低迷し、第3四半期以降、生産活動の大幅な縮小などが影響したためです。

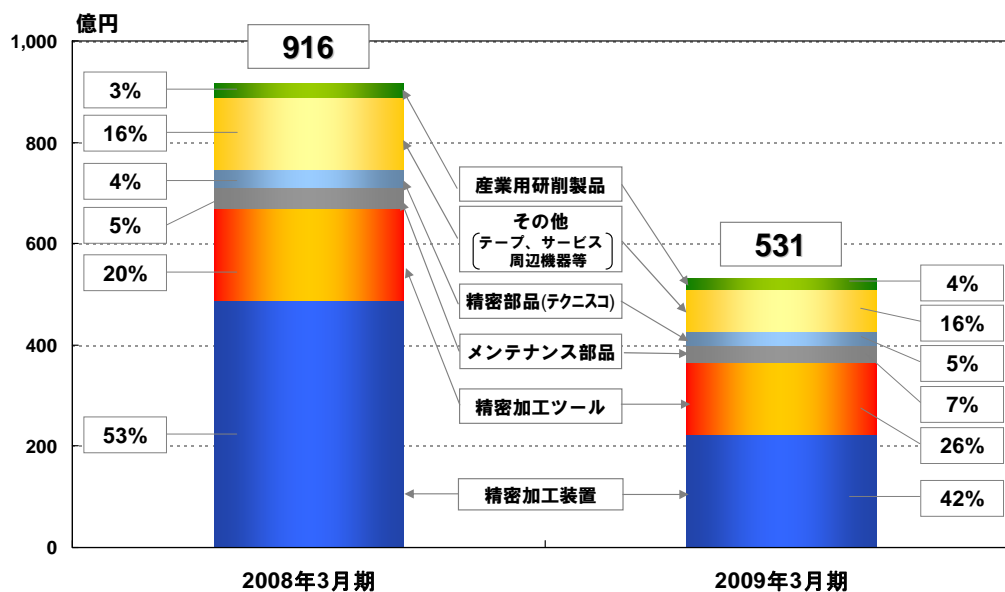
連結売上高・受注高 四半期推移



- 世界同時不況の影響で、第3四半期・第4四半期それぞれ前四半期比40%近く落ち込む
- 世界的な稼働率の低迷により、第4四半期はITバブル崩壊時と同水準の四半期売上高・受注高となった

四半期推移の売上高は、2008年度の1Qから2Qは横ばい、
3Q、4Qは前四半期比（QoQ）で40%ずつの落ち込みとなりました。

連結売上高 製品群別構成 前期比較

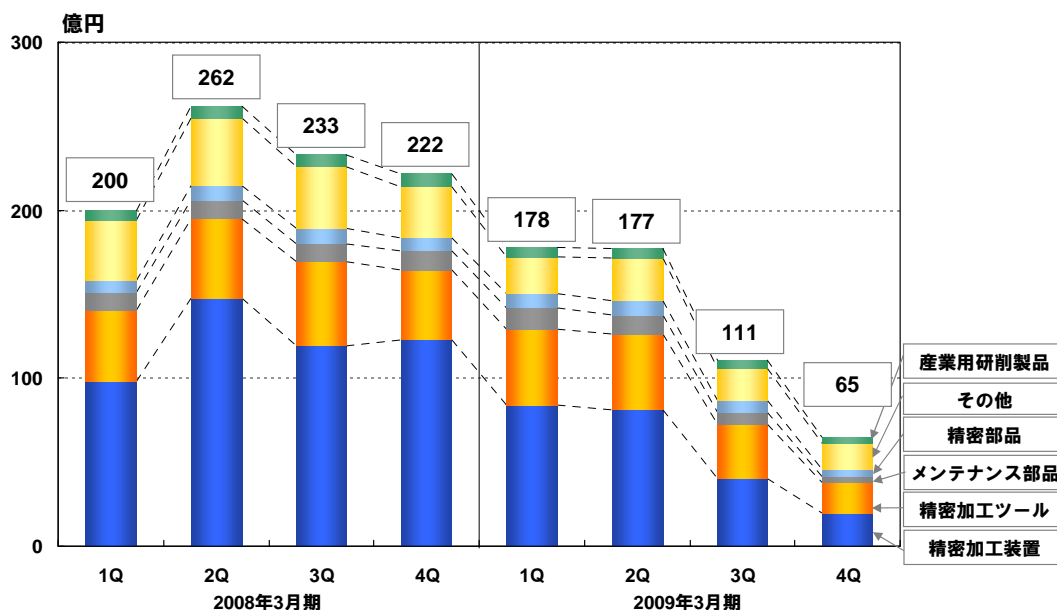


- 厳しい事業環境を受け、全ての製品群で売上高が減少し、特に精密加工装置は前期比54%下落した
- 過去6年間年率16%程度の成長をしていた精密加工ツールも前期比22%減少した

製品群別の販売構成比の比較です。全ての製品群で売上が減少しましたが特に「精密加工装置」は前期比54%減少しました。

「精密加工ツール」も構成比では、装置の不振で20%から26%へと増加していますが、売上の絶対額では直近の6年間が年率で16%程度の伸びを示していたのに対し、2008年度は前期比22%減少する結果となりました。

連結売上高 製品群別構成 四半期推移



- 過去最高の売上高を計上した前期と比較して、期初から精密加工装置は半導体不況の影響を受けた
- 下期に入り、精密加工ツールは前半期比44%下落し、過去最悪の下げ幅となった(01年度は38%減)

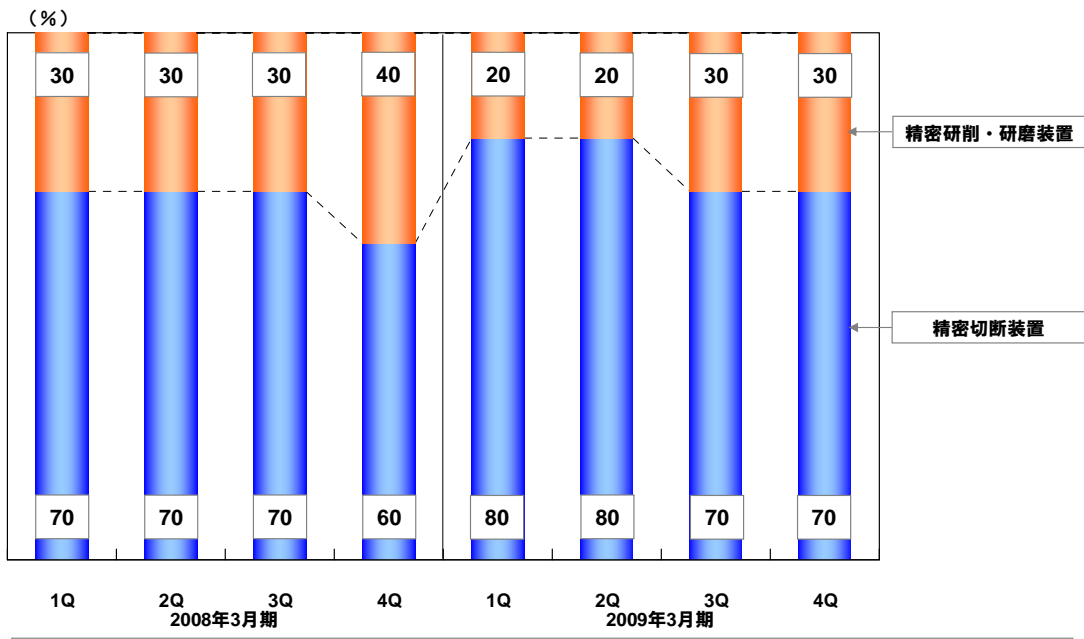
製品群別の四半期毎の推移です。

1Q、2Qは横ばいとなっておりますが、特に過去最高の売上を記録した2007年度と比較すると、装置は2008年度の期初から半導体不況の影響を受けました。

また精密加工ツールも2008年度上期までは高い水準を保持していましたが、2008年度下期は上期比で44%下落し、過去最悪の下げ幅となりました。

ちなみに2000年度下期対2001年度上期比較は38%減でした。

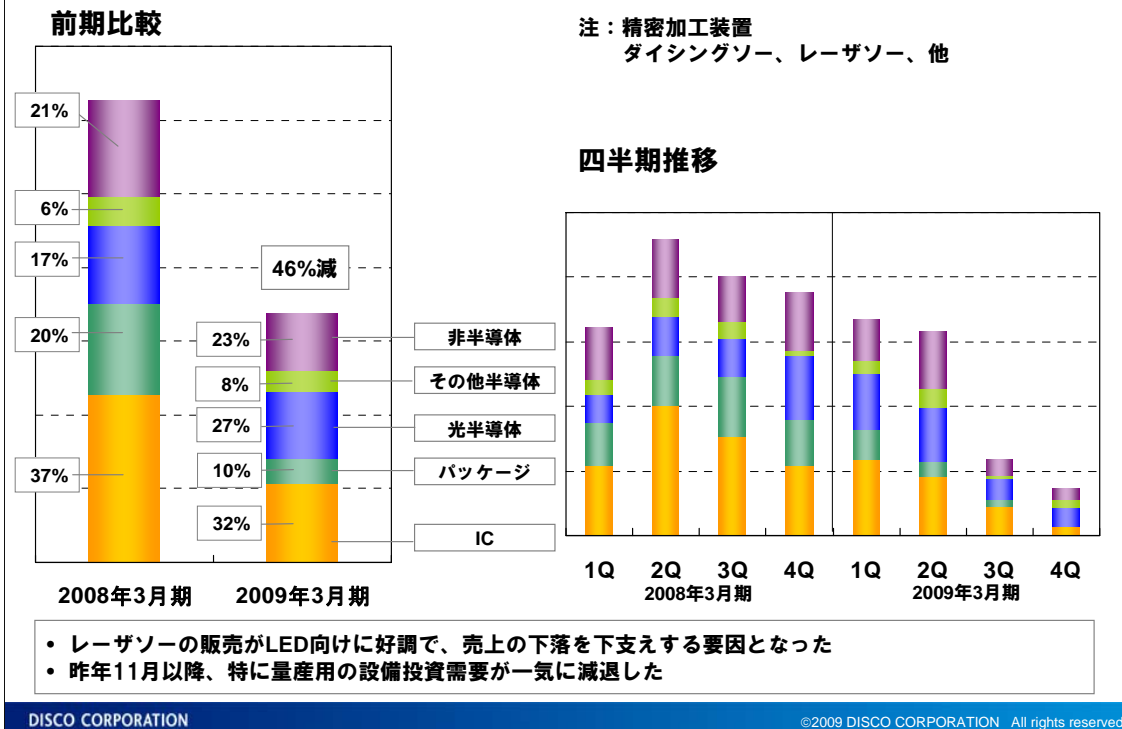
精密加工装置 構成比概数 四半期推移



• これまで売上を牽引してきた研削・研磨装置は、メモリ及びウェーハメイキングの投資が大きく鈍化し構成比が縮小した

装置の切断装置と研削・研磨装置の構成比です。
 研削・研磨装置は、2008年度の期初より半導体メモリ、
 素材ウェーハメイキングの投資が鈍化しておりましたので相対的に構成比が縮小しました。

精密切断装置* 売上構成 (アプリケーション別・単体)



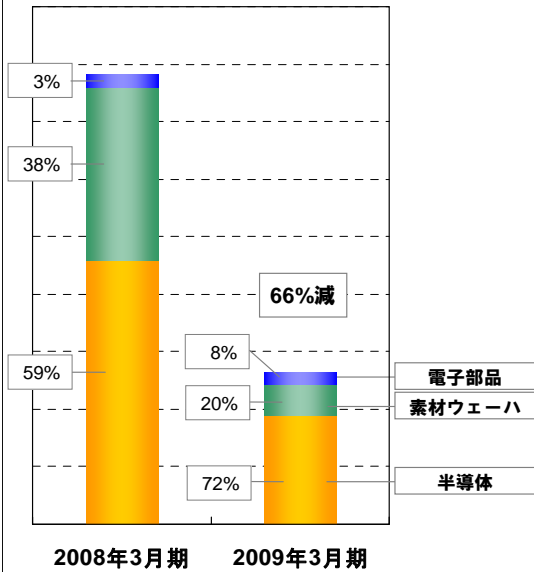
精密切断装置の用途別売上高推移(単体)です。

精密切断装置の中ではLED向けのレーザーの販売が好調でした。

LED向けレーザーは光半導体に分類しておりますが、売上全体の落ち込みを下支えすることとなりました。

しかし全体としては、11月以降、特に量産用の設備投資需要が急速に減少した影響を受け、売上高が大きく減少いたしました。

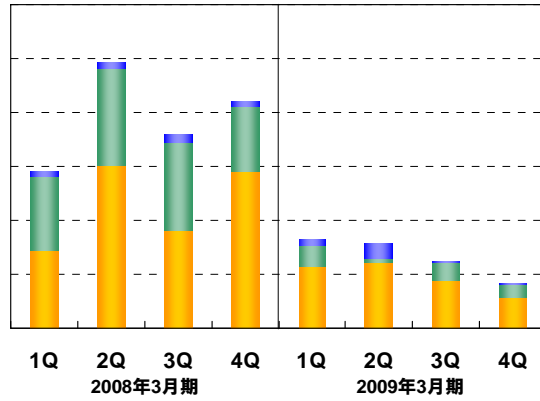
前期比較



注：精密研削・研磨装置

グラインダ、ポリシャ、グラインダポリシャなど

四半期推移

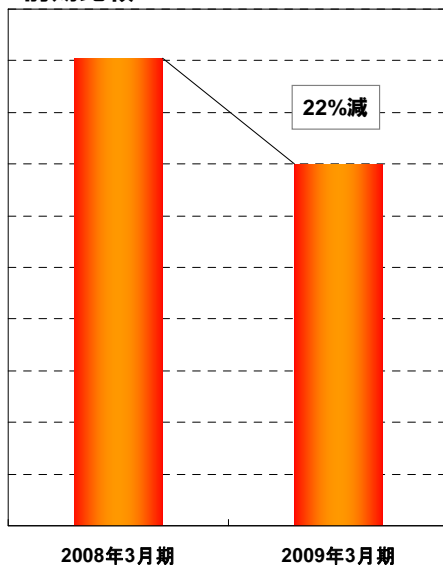


- メモリー不況の影響を大きく受け、薄化用研削装置の出荷が一部サブコンを除き、低水準に留まった
- 素材ウェーハ向け研削装置も投資一巡のため、前期と比較し大幅に下落した

精密研削・研磨装置の用途別推移です。

売上高は2008年度の期初より薄化、素材ウェーハ、共に前期に比べ大幅に下落いたしました。

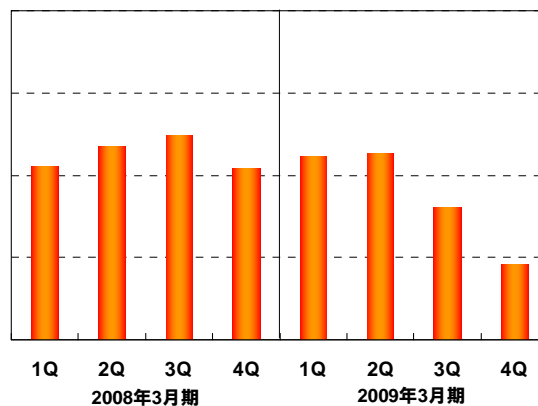
前期比較



注：精密加工ツール

ダイシングブレード、グラインディングホイール、
ドライポリッシングパッド他

四半期推移



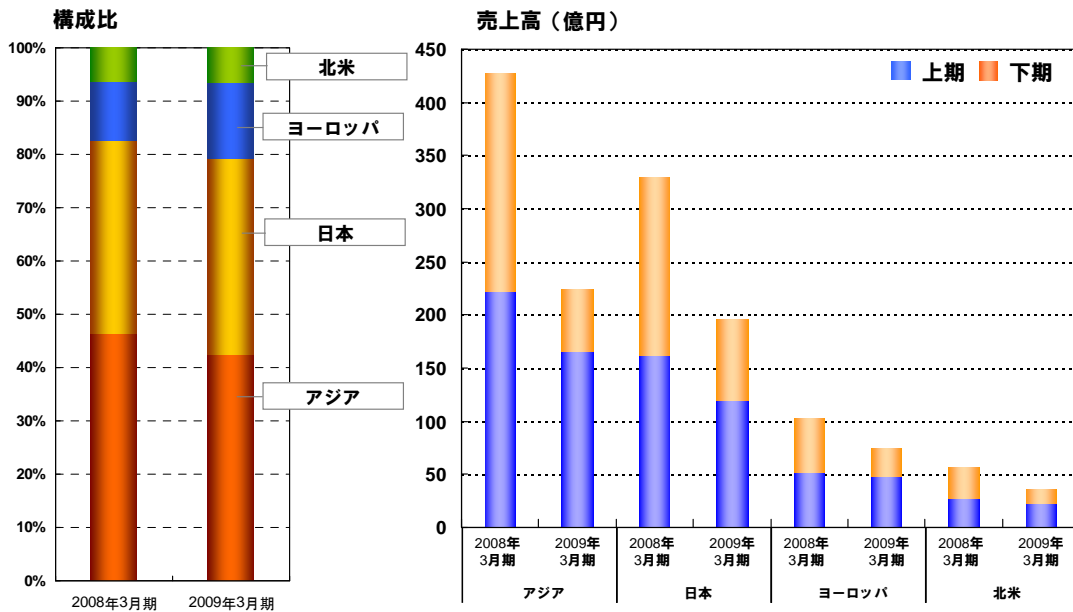
- 上期は好調な稼働率に支えられ堅調な推移となったが、昨年11月以降、月を追うごとに出荷額が減少した
- 年度末に入り、減産傾向に歯止めがかかり、受注が若干持ち直した

ダイシングブレード、グラインディングホイールなどの精密加工ツールの売上高推移です。

上期は比較的堅調に推移しましたが昨年11月以降、金融危機発生後の急激な景気の悪化を受け、月を追うごとに出荷額が減少しました。

足元では、売上高は1月、受注高は2月を底に、持ち直してきております。

地域別売上高 前期比較



- 売上高が大きく縮小する中でも高付加価値な事業を展開しているヨーロッパの割合が高まる
- 量産拠点となっているアジア及び日本は、下期に世界同時不況の影響をより強く受けることとなった

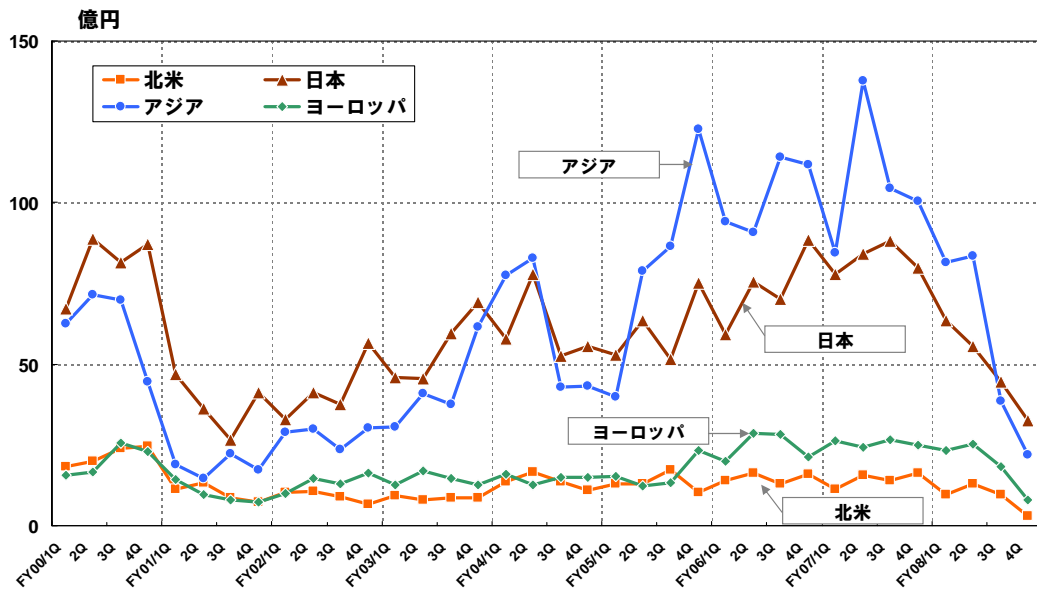
地域別の売上高とその構成比です。

相対的に、ヨーロッパのウェイトが高まりました。

これは研究開発用途などのニーズもあり、高付加価値の事業を展開しているため、下期の売上の上落幅が小さかったためです。

しかし、量産拠点であるアジア・日本においては下期、世界同時不況の影響を強く受けました。

地域別売上高 四半期推移



- アジア地域のうち、特に韓国向けの前期からの売上の下落幅が最も大きく、台湾は相対的に堅調であった

地域別売上高の四半期毎推移です。

日本に比べてもアジアの落ち込みが大きくなっております。

特に韓国向けの下落幅が大きく、一方台湾は相対的に堅調でした。

2009年3月期決算概要

(単位: 億円 四捨五入)	2008年3月期	2009年3月期	比較差異	
			金額	(%)
売上高	916	531	△385	-42.0%
売上総利益	469	251	△218	-46.5%
GP率	51.1%	47.2%	-	-
販売管理費	275	250	△25	-9.2%
営業利益	193	0.8	△193	-99.6%
経常利益	186	15	△171	-92.1%
経常利益率	20.3%	2.8%	-	-
税前利益	185	8	△177	-95.8%
当期純利益	111	3	△109	-97.7%
一株あたり利益(円)	327.07	7.41	△319.66	-97.7%
減価償却費	37	47	10	27.5%
設備投資費	100	135	35	34.5%
研究開発費	83	85	2	2.4%

- 売上高は大きく落ち込んだものの、各種不況対策や為替差益等により黒字を確保した
- 生産量の急激な減少により工場の稼働率が低下したことから、前期と比較してGP率が悪化した

2008年度決算概要です。

売上531億円(前期比42%減)、営業利益0.8億円(同99.6%減)、
経常利益15億円(同92.1%減)、純利益約3億円(同97.7%減)
と厳しい環境のなか黒字を確保いたしました。

特記事項としましては、GP率が生産量の急速な落ち込みで工場の稼働率が低下し悪化しています。

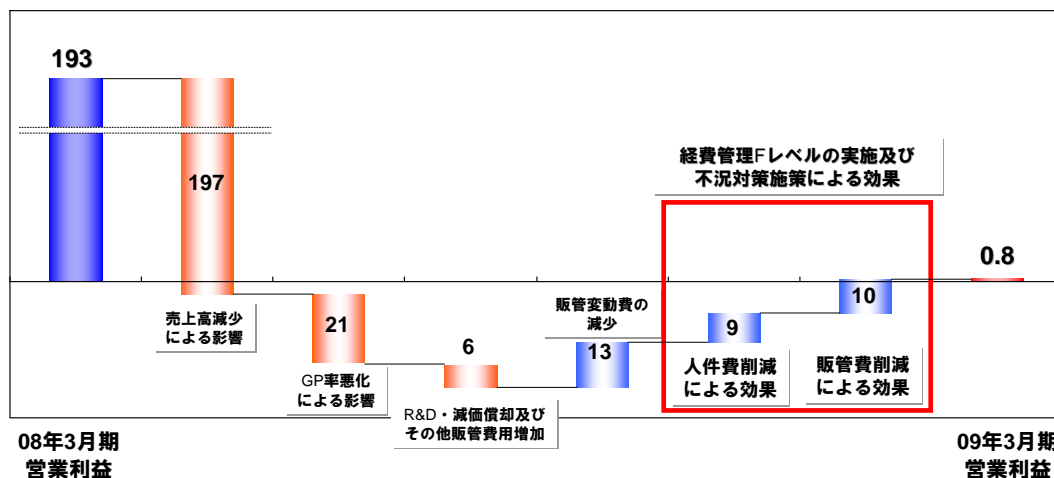
- ・営業外収益では 工場助成金6億円、為替差益 3.5 億円
- ・特別損失では 工場建替時の旧棟除却損 4.6億円

1月の業績予想では連結当期純損失 6億円と予想しておりましたが、最終黒字化しました。

要因としては税金の影響は 税効果でプラス3億円、さらに2009年度の税制改正で海外からの
配当金の95%益金不参入でプラス3億円、計6億円の効果があり利益が増加したためです。

営業利益 要因分析

(単位：億円)



- 売上高の大幅な減少とGP率の悪化により営業利益は大幅に悪化
- 経費管理Fレベルの徹底、残業規制及びその他不況対策の実施により約19億円のコスト削減効果となった
- 連結営業利益は0.8億円(76百万円)となり、黒字を確保した

この表は、営業利益段階で2007年度と2008年度の営業利益低下の要因を分析したものです。やはり売上高減少とGP率悪化の影響が大きく、さらに販管費に含まれる減価償却費増加などが利益をさらに押し下げました。

一方で事業環境の悪化に伴い設定した経費管理Fレベルによるコスト削減や残業規制、業績連動の賞与削減などを行い19億円改善し、0.8億円(76百万円)の営業利益を確保しました。

バランスシート(抜粋)

(単位: 億円 四捨五入)	2008年3月期	2009年3月期		増減
	期末(08年3月31日)	上期末(08年9月30日)	期末(09年3月31日)	2008年3月期末 2009年3月期末比較
流動資産	699	557	663	△36
現預金	191	126	334	144
受取手形・売掛金	271	204	110	△161
たな卸資産	199	192	188	△12
その他	38	34	31	△6
固定資産	487	531	576	89
有形・無形固定資産	421	462	493	72
投資その他の資産	66	68	83	17
資産合計	1,186	1,088	1,239	53
負債合計	289	183	376	87
流動負債	264	159	119	△145
固定負債等	26	24	257	232
(内 有利子負債)	(6)	(7)	(277)	(271)
純資産合計	897	905	863	△33
自己資本比率 (%)	75.0%	82.7%	69.2%	-
負債純資産合計	1,186	1,088	1,239	53

- ・ 不況下でも安定した事業運営を可能とするため、資金調達を行い、271億円の有利子負債が増加した
(有利子負債＝短期借入、1年内長期借入、長期借入、一年内社債、社債)
- ・ 自己資本比率は2008年3月期末の75.0%から69.2%へ低下した

B/Sの特記事項です。

- ・ 現預金の増加 144億円
- ・ 売上全体の減少に伴い受取手形・売掛金(▲161億円)
負債の支払手形・買掛金(流動負債▲145億円)が各々減少しています。
- ・ 棚卸資産の減少 12億円
- ・ 有形固定資産の増加 72億円
主なものは本社・R&Dセンターの完成(建物81億円等)です。

負債では270億円の長期借入等を実行しています。

キャッシュフロー(抜粋)

(単位: 億円 四捨五入)	2008年3月期	2009年3月期	増減
営業キャッシュフロー	93	46	△47
税前純利益	185	8	△177
減価償却費	37	47	10
売上債権・たな卸資産・仕入れ債務	△35	74	109
法人税等の支払額	△89	△29	60
その他	△4	△53	△49
投資キャッシュフロー	△118	△136	△18
有形固定資産の取得による支出	△94	△137	△42
定期性預金の預入による支出・収入他	△24	1	25
財務キャッシュフロー	△32	244	275
短期・長期借入金、社債による収入等	4	271	267
親会社による配当金の支払額	△27	△18	9
その他	△8	△9	△1
フリーキャッシュフロー	△25	△90	△65
現金および現金同等物の増加額	△60	154	213
現金および現金同等物の期末残高	181	334	154

- 営業CFは、税前純利益が8億円だったが売上債権の回収などにより46億円の資金増加
- 投資CFは、本社・R&Dセンター拡張及び桑畑・茅野工場新棟の建設代金支払いなどにより136億円の資金減少
- 財務CFは、資金調達を先行的に実施し総額270億円を借入れたことにより244億円の資金増加

2008年度の全体のキャッシュ・フローの動きとして、既に保有していた現預金で本社・R&Dセンターを建設し、桑畑工場の新棟、茅野工場の新棟を建設を進めていたところ、2008年後半からの事業環境の悪化により、桑畑と茅野工場の建設計画を見直しを行い、キャッシュアウトの抑制に努めました。

一方で不況がさらに長期化する場合を考え、金融機関より270億円の長期借入等を行い現預金で保有中です。

2010年3月期通期 連結業績見通し

(単位: 億円 四捨五入)	2010年3月期 予想			(ご参考)	
	上期	下期	通期	2009年3月期 通期実績	通期 対前年比較
売上高	193	247	440	531	△91
営業利益	△19	7	△12	0.8	△11
経常利益	△21	6	△15	15	△30
経常利益率	-10.7%	2.2%	-3.5%	2.8%	-
当期純利益	△15	1	△14	3	△17
減価償却費			54	47	△7
設備投資			91	135	△44
研究開発費			68	85	△17

- 世界的な不況の影響を受け、厳しい事業環境が続く見通し
- 下期にかけて、徐々に生産活動・投資活動が改善すると想定
→連結売上高は前期比17.2%減少の440億円と予想
- 精密加工装置は対前年比3割程度の減少、精密加工ツールは同1割程度の減少を見込む
- 想定為替レート US\$:95円/Euro:125円/SGP\$:60円
- 為替1円あたり影響額 US\$ /109.5百万円 Euro /17.9百万円

2009年度の計画です。

1年を通して厳しい事業環境が続くと見込んでおります。

連結売上高は、440億円(前期比17.2%減)を予想しております。

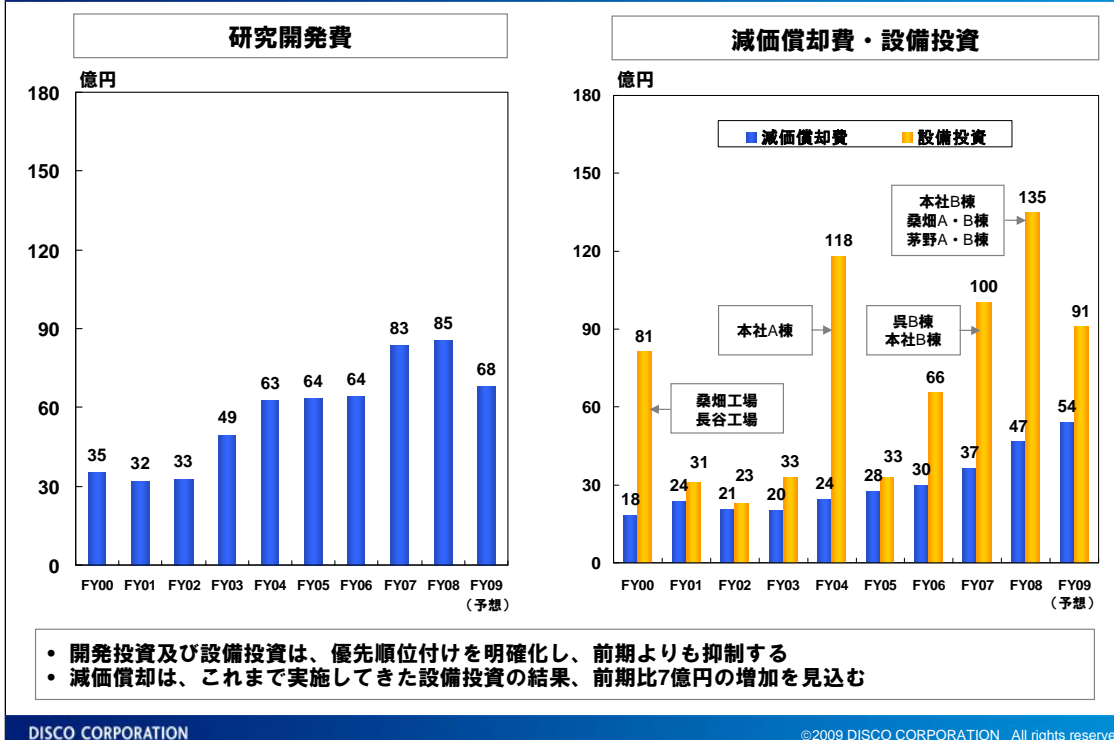
その内訳の構成は装置は前期比30%減少、消耗品は同10%程度減少とみております。

損益は、営業損失12億円、経常損失15億円、当期純損失14億円、を見込んでおります。

なお営業外損益、特別損益で特に大きなものは見込んでおりません。

2009年度の上期、下期の売上高推移としては、下期に向け緩やかに回復し、下期には黒字化するものと考えております。

なお、為替感応度はUS\$で1円あたり1億円の影響と考えております。



研究開発費、設備投資費、減価償却費の実績推移および計画値です。

●2009年度計画

・研究開発費 68億円

前期比約20%削減となりますが、研究テーマに優先順位を付けて抑制します。

・設備投資費 91億円

内訳は 通常投資25億円、桑畑工場の新棟65億円(2008年度35億円支払済)の予定です。

・減価償却費 54億円

一連の建物完成により償却費が前期比7億円増えております。

	中間期	期末	年間
2009年3月期	10円	10円	20円
2010年3月期(予想)	10円	10円	20円

- 2010年3月期は連結当期純損失を予想
- 配当政策に基づき、安定配当「1株あたり年間20円」を適用

【配当方針】

1. 連結業績に連動した配当（配当性向20%）
2. 安定配当として最低20円の配当金を維持。ただし3期連続で連結純損失の場合を除く
3. 4年累計連結売上高経常利益率が20%を達成した場合、通常20%である配当性向を24%とする
4. 赤字の場合を除き、配当及び法人税支払い後の現預金残高が予定必要資金額(*)を超過した場合は、上記1.に加え、超過金額の3分の1を目処に配当に上乘せする

配当ですが、当社は連結業績に連動して20%の配当性向を基本方針としております。


しかし、09年度の連結業績は当期純損失の見込みですので、安定配当の最低20円とさせて頂く予定です。

事業環境と経営方針

代表取締役会長
溝呂木 齊

●2008年度

2008年度下期の事業環境について

- 世界的不況により最終製品需要の大幅な落ち込み
 - 半導体業界はさらに厳しい状況→業界再編へ
 - ◆ 売上の減少
 - ◆ 在庫の増加
 - ◆ 資金繰りの悪化
- 
- ◆ 設備投資凍結
 - ◆ 大規模な減産, etc

当社の事業について

- 当社業績も極めて厳しい結果となる
 - ◆ 連結売上高531億円（前年比42%減）、純利益は3億円（同98%減）
 - ◆ 売上高・受注高は、ITバブル崩壊時以来の大幅な落ち込みを記録
 - ・ ITバブル時の落ち込みよりも受けた衝撃は大きい

2008年度は世界的不況により最終製品需要の大幅に落ち込み、半導体業界においても厳しい状況でした。当社も装置の売上高が昨年10月から大きく落ち込み、消耗品である精密加工ツールについても11月から急速に落ち込みました。

ピーク時からの落ち込みを見ますと、装置では2007年度2Qから2008年度の4Qと比較すると84%の減少となり、ITバブル時の落ち込みよりも衝撃が大きいものでした。

●2008年度(続き)

当社の事業について

□ 精密加工ツール

- ◆ 上期は底堅い動き
- ◆ 11月以降、これまで経験したことのないレベルの減産に見舞われる
- ◆ 年度末3月には受注が底打ちし、上昇に転じる

□ レーザ事業

- ◆ 不況下にあっても今後の成長の軸となる分野
- ◆ LED向けの出荷が好調
- ◆ 積極的な開発活動を継続

2008年度の連結業績は迅速な不況対策や経費管理の徹底等により
営業・経常・純利益とも辛うじて黒字を確保した

精密加工ツールですが、2008年度の1Q、2Qにおいては高水準で推移していましたが、11月以降にこれまでに経験したことのないレベルでお客様が減産した影響を受け、売上高は急激に減少しました。しかし、3月には受注高が上昇に転じるなどの動きが見られました。

レーザ事業は厳しい不況下でも、LED向けレーザソーの出荷が好調で健闘しました。

以上のような状況下で、2008年度の業績は辛うじて黒字を確保しました。

時期 (2008年度)	経費管理 レベル	経費管理の指針
4月	A	<ul style="list-style-type: none"> 明らかに不要なものを除き、支出を認める。 経費の削減は常に意識する
↓	B	<ul style="list-style-type: none"> 売上高経常利益率20%以上を目指すために、経費の削減を意識する。 <例>複数人の海外出張は、稟議を申請する
7月	C	<ul style="list-style-type: none"> 経費の削減を意識し、活動の質や頻度の見直しを行う。 <例>海外出張時のビジネスクラス使用を制限
↓	D	<ul style="list-style-type: none"> 各部門で経費支出を徹底的に精査する。 <例>複数人の国内出張は、稟議を申請する
10月上旬	E	<ul style="list-style-type: none"> 各部門で経費支出を徹底的に精査し、あらゆる経費の支出はディビジョン長決裁以上とする <例>複数人の国内出張は、社長決裁
↓	F	<ul style="list-style-type: none"> 上記Eレベルに加え、お客様への製品・サービスの提供に直接関係がある経費以外の経費支出は徹底的に見直す。

• 連結販管費 2007年度 275億円 → 2008年度 250億円 (前年比△25億円)
 四半期推移 (2008年度) 1Q 69億円 → 2Q 67億円 → 3Q 64億円 → 4Q 51億円

こちらは予想経常利益に応じて設定している経費管理レベルの表です。

この経費管理規定は今回の不況に伴って作成したものではなく従来より策定していたもので、予想経常利益率に応じて経費管理の指針を設定するものです。

Fレベルについては従来無かったのですが、今回の不況に伴って追加設定し、徹底的に経費を圧縮してまいりました。

●2009年度の見通し

事業環境について

- 世界的な大不況の壊滅的状态からは脱しつつある
⇨最終製品需要の回復は不透明

- 半導体市場では設備過剰感が解消されていない
 - 従来の量産対応用設備投資の見込みは薄い
 - 新分野・新技術に対する設備投資の動きはある
 - ◆TSV
 - ◆エコ関連 省エネ (LED、・・・)、環境関連 (TAIKO、DWR1720)
 - ◆その他

- 在庫調整の進捗→顧客の稼働率改善の動き→精密加工ツールの回復傾向
- どの程度回復するかは、もう少し見極めが必要

2009年度の見通しについてですが、最終需要が減少しており、アメリカ自動車業界の動向や雇用問題が景気と関連してくると思われま

半導体市場については設備過剰感が解消されておらず、従来の量産対応用設備投資の見込みは薄いと考えております。

しかし、携帯電話やLED向けで、まばらですが動きがあり、当社の生産計画でも中国・台湾向けに具体的な案件が入ってきております。一方、韓国、シンガポール向けの案件は低調です。

また、新分野・新技術に対する設備投資の動きがあります。しかし量としては全体をカバーするものではありません。TSVでは薄化や電極の平坦化、エコ関連ではLED向けの高い伸びが予想されており、これら向けのグラインダやレーザなどが期待されます。(LEDは大型テレビ、パソコン、携帯電話用のバックライト向け) また環境関連としては、自動車用デバイス(IGBT)の対応するTAIKOや、小型純水リサイクル装置(DWR1720)が期待されます。

精密加工ツールについては、お客様の在庫調整が進み稼働率改善の動きが見られます。韓国・台湾・シンガポールなど地域に関わらず、精密加工ツールの上昇傾向が各地に見られますが、どの程度回復するかはもう少し見極めが必要であると感じています。

●2009年度について

2009年度は厳しく、不透明な事業環境を想定

- ・連結売上高440億円、営業損失12億円

今後の回復に備え、組織をより筋肉質に鍛える良いチャンス

- 企業理念の浸透・PIM活動*の推進を基本とし、年度方針の徹底を図る
 - VISION達成の加速
 - 強化すべき項目
 - ◆VISION達成のテーマ
 - ◆各本部毎の事業テーマ
 - ◆選択的な不況対策(残業規制の継続、コストの削減)
 - ◆構造的経費削減5%の継続
 - KKM分野への研究開発投資・効率化投資は継続
 - 不況対策を継続しながらも、市場動向への迅速な対応

注:当社独自の業務プロセスを常に進化させるための活動。あらゆる部門で実践。

世界同時不況により、最終製品市場の需要が減少し、
半導体・電子部品業界も大きな影響を受けている

このような不透明な環境ではあるが

- DISCO VALUESの浸透活動・・・組織の一体感の強化
 - PIM活動・・・進化活動の推進
- 等の基本活動を継続する

- 必要な研究開発テーマの推進
- コスト削減の徹底
- 業務プロセスの効率化

これら「喫緊の課題」と「将来のテーマ」にしっかり取り組んでいく

DISCO
Kiru · Kezuru · Migaku Technologies



DISCO CORPORATION